



平成24年3月30日

各 位

会 社 名 天昇電気工業株式会社
代 表 者 名 取締役社長 安藤 武彦
(コード番号 6776 東証2部)
問 い 合 せ 先 取締役管理本部長 横山 彰
T E L 042(788)1880

コミット型シンジケートローン契約締結に関するお知らせ

当社は、平成24年3月30日付けで、株式会社三井住友銀行をアレンジャーとするコミット型シンジケートローン契約を締結いたしましたので、お知らせいたします。

記

1. コミット型シンジケートローンの概要

- | | |
|-------------|--|
| (1) 契約金額 | 総額21億円 |
| (2) 契約締結日 | 平成24年3月30日 |
| (3) コミット開始日 | 平成24年4月4日 |
| (4) 満期日 | 平成31年3月29日 |
| (5) 契約形態 | コミット型シンジケートローン |
| (6) 資金使途 | 運転資金及び設備資金 |
| (7) アレンジャー | 株式会社三井住友銀行 |
| (8) エージェント | 株式会社三井住友銀行 |
| (9) 参加金融機関 | 株式会社三井住友銀行、株式会社十六銀行
株式会社大垣共立銀行、中央三井信託銀行株式会社 |

2. 今後の業績に与える影響

本件が、当社の業績に与える影響は、平成24年2月7日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に織り込んでいるため、業績予想の変更はありません。

以 上